

Title (en)

METHOD FOR GENERATING AND USING COLD, AND DEVICE FOR IMPLEMENTING SUCH METHOD.

Title (de)

VERFAHREN ZUR KÄLTEERZEUGUNG UND -ANWENDUNG SOWIE VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DIESES VERFAHRENS.

Title (fr)

PROCEDE POUR GENERER DU FROID ET POUR L'UTILISER, ET DISPOSITIF POUR LA MISE EN UVRE DE CE PROCEDE.

Publication

EP 0255527 A1 19880210 (FR)

Application

EP 87900635 A 19870116

Priority

- CH 17886 A 19860118
- CH 17986 A 19860118
- CH 18186 A 19860118

Abstract (en)

[origin: WO8704510A1] The disclosed method and device are characterized in that they make it possible to generate, by siphon effect, in a housing (10) containing a cold-accumulating and freezable liquid (12), a current of liquid in a closed hydraulic circuit, said current comprising at least an ascending current which is situated over means (15) for injecting a refrigerating fluid (16) and contains bubbles of this atomized refrigerating fluid, and at least one descending current free of refrigerating fluid in the gas phase.

Abstract (fr)

Le procédé et le dispositif sont caractérisés en ce qu'ils permettent d'engendrer, par effet siphon, dans une enceinte (10) contenant un liquide (12) congelable accumulateur de froid, un courant de liquide en circuit hydraulique fermé, ce courant comportant au moins un courant ascendant localisé au-dessus de moyens d'injection (15) d'un fluide frigorigène (16) et contenant des bulles de ce fluide frigorigène vaporisé, et au moins un courant descendant dépourvu de fluide frigorigène à l'état gazeux.

IPC 1-7

F25C 1/00; F25D 3/00

IPC 8 full level

F25D 3/10 (2006.01); **F24F 5/00** (2006.01); **F25C 1/00** (2006.01); **F25D 16/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

F25C 1/00 (2013.01 - EP US); **F25D 16/00** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 8704510A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

WO 8704510 A1 19870730; EP 0255527 A1 19880210; JP S63502923 A 19881027; US 4840652 A 19890620

DOCDB simple family (application)

CH 8700008 W 19870116; EP 87900635 A 19870116; JP 50060887 A 19870116; US 11072387 A 19870917